**艾姆勒車電需求**

* 實習生需求： ( 職務類別：研發與製程開發 )
* 工作地點：

林口 (研發與製程開發)

銅鑼 (製程開發)

* 能力需求：(理工背景)

物理、化學、材料、化工、機械

* 工作內容：

散熱結構設計與模擬、產品設計、材料開發 (散熱材料、濕式清潔藥水、金屬硬焊材料、金屬粉末冶金材料、金屬特性分析、材料量測與分析)、製程開發(模具、製具、檢具、刀具、動線流程設計、製程參數設計)、機台開發 (自動化與半自動化機台開發、電控PLC設計、機構與組裝設計)

* 專利授權需求：

關鍵字 – IGBT Structure、Direct Bonding Circuit、Thermal solution ( material, structure )、ADAS system control、Polymer thermal material、Organic thermal material、Thick copper circuit、Spray ceramic、Spray copper powder

* 產學合作需求：
1. IGBT結構應力模擬 (Multilayer structure)
2. 高功率散熱水冷系統設計
3. 粉末高壓噴塗技術

**今網智慧科技需求**

* 實習生需求： ( 職務類別：軟體研發開發 )
* 工作地點：

台中 (軟體研發)

台北 (軟體研發)

* 能力需求：(3項選一項皆可)

1.OOP、design pattern

2.C# or Java or objective C or swift(擇一項)

3.javascript、css、html5、vue framework

* 工作內容：

APP 前台程式撰寫、APP後台程式撰寫、資料庫架構建立、公司內MIS系統維護、資訊安全架構建立

* 專利授權需求：

關鍵字 – 社區E化系統、智慧社區系統、智慧居家系統、推播通知系統、電商架構、線上交易架構、客戶輪廓、SOLOMO、Business Smart Matching、Business need discovery

* 產學合作需求：
1. 資訊安全
2. Persona 架構與智慧分析 (Smart Matching and need discovery)
3. 商品智慧化推薦架構 (Smart Matching and need discovery)